



# 科技硬件周报：关注虚拟现实 实行业应用发展趋势



## 行业动态

## 行业近况

上周(10/31-11/04)SW 电子指数上涨 8.4%, SW 通信指数上涨 4.1%, 恒生科技指数上涨 15.6%, 标普 500 指数下跌 3.3%, 纳斯达克指数下跌 5.6%, 费城半导体指数下跌 1.5%。

## 评论

半导体方面:上周, Intel 宣布将于 2023 年 1 月 10 日推出可搭载 DDR5 内存模组的 Sapphire Rapids 第四代可扩展至强处理器。我们看好国产 FPGA 和 DDR5 细分赛道。模拟芯片受下游应用景气度分化影响, 国内公司营收环比增速普遍放缓, 我们预计模拟芯片下游景气度将维持分化态势, 建议关注国内布局新能源汽车、光伏等高增长领域的龙头公司。制造方面, 晶圆厂龙头产能利用率下行, 未来半导体材料端需求及收入增速或将承压, 但中长期角度而言, 我们仍看好国内半导体设备、材料零部件国产替代进程加速。半导体设备材料及零部件建议关注芯源微、江丰电子、安集科技等; 半导体设计建议关注安路科技、澜起科技、圣邦股份等; 功率半导体建议关注斯达半导。

消费电子方面: 五部委联合发布文件推动我国虚拟现实产业大规模发展, 确定 Fast-LCD 等近眼显示发展趋势, 强调对辐辏调节冲突、光场显示等方向, 在应用场景方面, 提到包括工业、文旅、融合媒体及教育培训等

多个“虚拟现实+”。我们认为随着文件对核心技术的重视度提高，有望推动相关技术加速成长，实现更早的商业化落地。建议投资人关注后续政策扶持方向，以及歌尔股份、立讯精密、兆威机电、长盈精密、舜宇光学、德赛电池、利亚德、光峰科技、紫建电子（未覆盖）等 ARVR 产业链相关公司。

汽车电子及通信方面：工信部会同公安部发布文件，推动智能网联汽车落地。汽车电动化、智能化趋势下，国内主机厂在车联网方面积极布局，有望带动汽车电子行业需求增长。我们持续看好智能化为我国汽车行业带来的变革机遇，建议关注汽车智能化龙头德赛西威，CIS 传感器龙头封测公司晶方科技，智能座舱领域华阳集团，车联网通信模组龙头移远通信、广和通，车内高速通信相关瑞可达、电连技术、立讯精密，车内上游零部件龙头科博达（汽车组与科技硬件组联合覆盖）。建议关注光纤光缆龙头中天科技、亨通光电。

## 估值与建议

维持所覆盖公司评级、盈利预测、目标价不变。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_48354](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48354)

